

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ASMPT enabling the
digital world

ASMPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

二零二三年中期業績新聞稿

有關 ASMPT Limited 及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月業績的新聞稿附載於本公告。

承董事會命
董事
黃梓達

香港，二零二三年七月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：Orasa Livasiri 小姐（主席）、樂錦壯先生、黃漢儀先生、鄧冠雄先生、張仰學先生及蕭潔雲女士；非執行董事：盧鈺霖先生及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：黃梓達先生及 Guenter Walter Lauber 先生。

(本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。)



ASMPT 公布二零二三年中期業績

二零二三年第二季度銷售收入高於預測中位數
戰略布局迎接生成式人工智能及高性能計算的增長

集團業績概覽

集團財務概要: 二零二三年第二季度

- * 銷售收入為港幣 39.0 億元(4.97 億美元), 按年-25.0%, 按季亦-0.4%
- * 新增訂單總額為港幣 30.2 億元(3.84 億美元), 按年-35.1%, 按季亦-14.9%
- * 毛利率為 40.1%, 按年-158 點子, 按季亦-33 點子
- * 經營利潤率為 9.9%, 按年-892 點子, 按季亦-197 點子
- * 盈利為港幣 3.08 億元, 按年-66.0%, 按季亦-2.3%

集團財務概要: 二零二三年上半年

- * 銷售收入為港幣 78.2 億元(9.98 億美元), 按年-25.3%, 按半年亦-12.1%
- * 新增訂單總額為港幣 65.6 億元(8.38 億美元), 按年-43.9%, 按半年亦-2.7%
- * 毛利率為 40.3%, 按年-89 點子, 按半年亦-86 點子
- * 經營利潤率為 10.9%, 按年-804 點子, 按半年亦-318 點子
- * 盈利為港幣 6.23 億元, 按年-64.1%, 按半年亦-29.5%
- * 每股中期基本盈利為港幣 1.52 元, 按年-63.9%, 按半年亦-29.3%
- * 中期股息每股港幣0.61元, 按年-53.1%
- * 於二零二三年六月三十日, 未完成訂單總額為港幣77.8億元 (9.93億美元)

二零二三年第三季度銷售收入預測

- * 將介乎 4.1 億美元至 4.8 億美元之間

詳盡業績公布及投資者簡報可見於

<https://www.asmpt.com/zh-tw/investors/financials-results/>

(二零二三年七月二十六日, 香港訊) — ASMPT Limited (「ASMPT」/「集團」) (股份代號: 0522), 公布集團截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績。作為一間全球領先之半導體及電子產品製造硬件及軟件解決方案供應商, 集團的技術使各類的客戶能夠為數碼世界創造廣泛的半導體和電子解決方案。

集團二零二三年上半年亮點

集團繼續受疲弱的行業狀況影響，包括消費開支及資本投資轉趨保守以及行業供應鏈庫存需持續消化。雖然 SMT 分部持續表現強韌，已連續四個季度貢獻集團大部份的銷售收入，但 SEMI 業務的復甦時間較預期長，因其客戶的廠房使用率雖逐步得到改善，可惜仍未達最佳水平。

在半導體產業持續低迷的情況下，集團獨特而廣泛的產品組合以及在其主要客戶的技術發展藍圖擔任關鍵夥伴的角色，為未來的增長奠定堅實的基礎。特別是，受市場對生成式人工智能、高性能計算（「HPC」）的強勁長期需求，以及汽車行業的持續需求所推動，集團將從先進封裝（「AP」）市場中受惠。

集團行政總裁黃梓達先生表示：「面對目前的市場狀況，我們上半年的業務仍保持穩健。矽增長的長期推動因素將繼續為我們的業務帶來強勁的支持。特別是，我們已準備就緒以支援生成式人工智能和 HPC 的強勁增長，尤其是我們市場領先的熱壓焊解決方案，提供了關鍵功能，包括卓越的高配置準確度，能滿足人工智能計算封裝的嚴格要求。」

集團對生成式人工智能領域的參與涵蓋其產品組合中的多種解決方案，並與關鍵客戶展開深入合作。集團的 AP 解決方案是支持生成式人工智能強勁增長的關鍵技術，這需要高精確焊接解決方案及最佳的總體擁有成本的緊密連結。亮點如下：

於二零二三年上半年，集團的 AP 解決方案的銷售收入約為 1.95 億美元，佔集團總銷售收入的 19%，其中，熱壓焊接（「TCB」）解決方案為 AP 貢獻最多銷售收入。

熱壓焊接方面，集團在解決生成式人工智能中關鍵邏輯和記憶體封裝瓶頸上處於卓越的位置。在邏輯方面，集團為主要客戶提供晶片與晶圓及晶片與基底連接工藝。鑒於配置日趨複雜，有關工藝對異構集成及人工智能計算封裝至關重要。高頻寬記憶體（HBM）方面，集團的解決方案能滿足新一代 HBM 嚴謹的封裝要求。隨著生成式人工智能大量出現，客戶將轉向此等先進 HBM 封裝，以應付持續增長的存儲和處理需求。

由於集團的 TCB 解決方案能應付多種互連類型，而集團的 TCB 解決方案亦憑其獨特的優勢，受惠於因複雜人工智能封裝所需的互連數量不斷增加，從而加速採用 TCB。

集團不斷獲得 HBM 的訂單，並繼續深化與多家記憶體企業的合作。來自晶圓代工客戶和 OSAT 客戶的邏輯類別訂單亦表現強勁。受惠於 AP 產能擴大，尤其是來自晶圓代工客戶的需求更是持續增長。因此，集團有信心在二零二三年下半年接獲更多邏輯及記憶體的 TCB 訂單。

受惠於生成式人工智能需求，集團不斷接獲來自全球頂級客戶的**覆晶回流焊接高精確固晶**解決方案訂單。至於**混合式焊接**方面，集團繼續與主要客戶合作在包括記憶體的不同終端市場中應用取得認可。

生成式人工智能的增長，亦推動了集團產品組合中的其他設備。當中包括**矽光子**（「SiPh」），集團領先市場的解決方案擁有高配置準確度於 SiPh 及共同封裝光學器件，如光學收發器及光子引擎相關。在此方面，為滿足生成式人工智能對高頻寬傳輸的需求，集團收到其設備的重複訂單，用於支援一位主要客戶的收發器擴充計劃。集團預期於二零二三年下

半年將接獲更多相關的訂單。在 **SMT 貼裝設備** 方面，受人工智能應用所推動，在處理大型伺服器主機板的重量及呎吋方面為客戶提供靈活性的設備，對伺服器業務具有吸引力。

於二零二三年上半年，集團的汽車終端市場應用為二零二三年上半年集團總銷售收入帶來最高的 23% 貢獻約 2.30 億美元。銷售收入貢獻涵蓋集團的主流解決方案，特別是 SMT 設備，塑封設備及固晶機。汽車解決方案在過去兩年為集團整體表現帶來重大貢獻，而該行業已開始趨於常態化。儘管如此，電動汽車企業及碳化矽應用的需求仍然強勁。集團的汽車解決方案繼續贏得設計項目，最終將轉化為大批量生產需求。

二零二三年上半年度集團財務回顧

集團於二零二三年上半年的銷售收入為港幣 78.2 億元(9.98 億美元)，按年及按半年分別下降 25.3% 及 12.1%，主要是由於 SEMI，而 SMT 則持平。如前所述，汽車市場貢獻最多，佔集團於二零二三年上半年的總銷售收入約 23%，銷售收入主要來自主流解決方案；工業市場維持穩健增長，主要來自 SMT。

受 SMT 影響，集團新增訂單總額按半年輕微下降 2.7% 至港幣 65.6 億元 (8.38 億美元)，而 SEMI 則由於低基數而有所增長。主要由於高基數效應，新增訂單總額按年下降 43.9%，但 AP、汽車和工業終端市場佔集團新增訂單總額約 57%。截至二零二三年上半年，集團的未完成訂單總額為港幣 77.8 億元 (9.93 億美元)，訂單對付運比率為 0.84。

集團毛利率為 40.3%，按年下降 89 點子，按半年下降 86 點子，部分受 SMT 佔集團總銷售收入約 59% 的分部組合影響。集團的經營利潤率為 10.9%，按年下降 804 點子，按半年下降 318 點子，盈利分別按年下降 64.1% 及按半年下降 29.5% 至 6.23 億港元。經營利潤率及盈利皆受到銷售量下降的不利影響。

於二零二三年六月三十日，集團的流動資金狀況穩健，現金及銀行存款總額達港幣 37.7 億元，而銀行借款則為港幣 20 億元。

二零二三年第二季度集團財務回顧

集團銷售收入為港幣 39.0 億元(4.97 億美元)，略高於先前預測之中位數，按季持平，但按年減少 25%，是由於高基數效應。集團新增訂單總額按年下降 35.1% 至港幣 30.2 億元 (3.84 億美元)，主要由於高基數效應，按季則下降 14.9%，是由於持續的行業下行週期。

集團毛利率為 40.1%，按年下降 158 點子，按季下降 33 點子，主要是由於 SEMI，即使 SMT 的毛利率已有所改善，亦只能部分抵銷 SEMI 帶來的下降。集團整體盈利能力按季微跌，這由於銷量下降而錄得按年下跌，集團的經營利潤率為 9.9%，按季下降 197 點子，按年下降 892 點子，盈利分別按季下降 2.3% 及按年下降 66% 至港幣 3.08 億元。

前景

受惠於汽車電動化，智能工廠，綠色基礎設施，5G，物聯網、生成式人工智能增長推動的 HPC 等長期結構性趨勢，集團的增長前景依然強勁。作為多個應用及解決方案領域的主要供應商及技術合作夥伴，集團擁有主要競爭優勢。

由於當前宏觀經濟環境，持續通脹、消費者情緒低迷及持續庫存需消化使短期內的可見度仍然有限。

綜合上述因素，集團預期二零二三年第三季度的銷售收入將介於 4.1 億美元至 4.8 億美元之間，以其中間數計分別按年及按季下跌 23.4 %和 10.5%，主要由於 SMT 行業常態化。

關於 ASMPT Limited (「ASMPT」)

ASMPT 是一間全球領先之半導體及電子產品製造硬件及軟件解決方案供應商。ASMPT 總部位於新加坡，產品涵蓋半導體裝嵌和封裝及 SMT(表面貼裝技術)，從晶圓沉積乃至於各種幫助組織、組裝及封裝精細電子組件的解決方案，以便客戶用於各種終端用戶設備，如電子產品、移動通訊器材、計算設備、汽車、工業以及 LED(顯示板)。ASMPT 與客戶緊密合作，持續投資於研究及發展，開拓具有成本效益和行業影響力的解決方案，為提升生產效率、提高產品的可靠性和質素貢獻力量。

ASMPT 在香港聯交所上市(香港聯交所股份代號: 0522)，並且是恒生綜合市值指數下之恒生綜合中型股指數、恒生綜合行業指數下之恒生綜合資訊科技業指數及恒生香港 35 指數之成份股。詳細資訊請查閱 ASMPT 網頁 <https://www.asmpt.com/>。

前瞻聲明

除歷史事實陳述外，本文所有陳述均是或可能是前瞻聲明。這些前瞻聲明反映 ASMPT 根據現時可得的資料所作出的假設，目前對未來的期望、信念、希望、意圖或策略。此等前瞻聲明並非就未來的表現或事件作出保證，並涉及已知或未知的風險和不確定性。因此，不同因素可能導致實際結果與前瞻聲明中包含的資料有重大差別。讀者不應過分依賴此等前瞻聲明，而 ASMPT 不會承擔任何公開地更新或修訂任何前瞻聲明的義務。本文中無任何陳述有意或可被解釋為盈利預測。

- 完 -

新聞垂詢:

林詒源 (Lim Ee Guan)
企業傳訊總監
電話: +65 6450 1445
電郵: eg.lim@asmpt.com

代表 ASMPT:

縱橫財經公關顧問有限公司
吳燕霞 / 卓愷瑩
電話: +852 2864 4812 / 2114 4979
傳真: +852 2527 1196
電郵: mandy.go@sprg.com.hk / christina.cheuk@sprg.com.hk